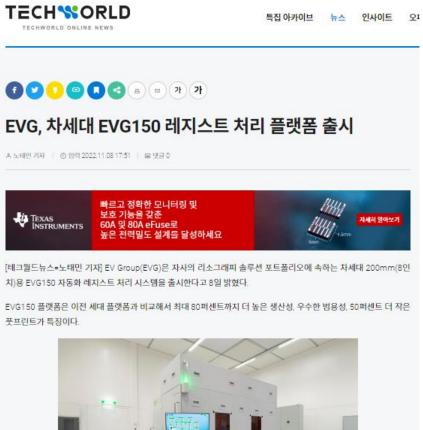


EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform - November 8, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. The redesigned EVG150 platform includes advanced features and enhancements that provide even greater throughput (by up to 80 percent) and versatility, as well as smaller tool footprint (by nearly 50 percent), compared to the previous-generation platform. "We've incorporated these learnings into our next-generation EVG150 system, which has been redesigned from the ground up to provide breakthrough throughput and cost-of-ownership benefits in a universal platform that offers unsurpassed flexibility to meet the widest variety of resist processing needs." stated Thomas Glinsner, corporate technology director at EV Group.





EVG가 차세대 EVG150 레즈스트 처리 플랫폼을 즐시했다. [사진=EVG]

범용 플랫폼으로서 신뢰할 수 있는 고품질 코팅 및 현상 공정을 가능하게 하므로, 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전 력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용할 수 있다. 새로운 장비는 우수한 생산성과 유 연성 및 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다.

8인치 기판용 차세대 EVG150은 이전 세대 플랫폼의 업계 선도적인 특성을 그대로 유지하고 있다. 이러한 특성으로는, 회전 및 분사 코팅, 현상, 베이크 및 냉각 공정을 위해 맞춤형 모듈 구성이 가능한 완벽하게 자동화된 플랫폼, 극히 복잡 한 형태의 컨포멀 코팅이 가능한 EVG 고유의 OmniSpray 기술, 지속적으로 높은 생산성을 달성하도록 듀얼 엔드 이펙 터 기능을 사용하는 정교하고 성능이 검증된 로봇 핸들링, 그리고 웨이퍼 에지 핸들링과 휘거나 뒤틀린 웨이퍼, 또는 박 막 웨이퍼를 취급할 수 있는 능력이 포함된다.

토마스 클린스너(Thomas Glinsner) EVG 기술 디렉터는 "레지스트와 패터닝 공정은 반도체 제조에 있어서 가장 반복 적으로 사용되는 공정들이다. EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성을 바 탕으로 고객들의 극히 까다로운 요구를 총족하는 솔루션을 제공한다"고 밝히고 "차세대 EVG150 시스템은 이러한 경 혐을 토대로 탄생한 것으로서, 법용 플랫폼으로 새로운 차원의 생산성과 비용 상의 이점을 달성하도록 설계되었으며 전례 없이 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 총족한다"고 말했다.

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=229518